

## HM200 带外管理模块



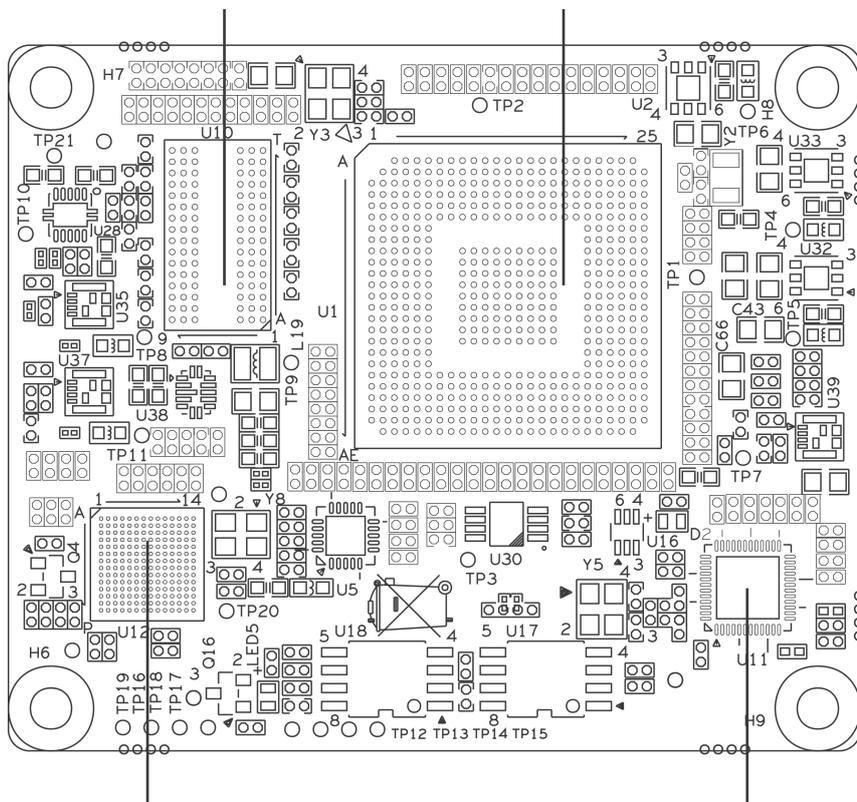
HM200为支持IPMI2.0接口协议的模块化BMC带外管理设备，支持上下电控制、温度检测、电压检测、电流检测、处理器资源状态信息获取、系统远程维护、健康信息上报及告警等功能；模块采用全铝合金封闭式外壳设计，整体尺寸为50mm\*30mm\*8mm（长\*宽\*高），对外通过高速连接器提供高度可选的叠层应用。

模块元器件的国产化率可以实现数量和种类双100%，能够广泛应用于通用服务器、ATCA、CPCI、VPX、PXIe等需远程运维的应用场景，提升设备的可靠性以及可维修性。

# HM200 带外管理模块 | 示意图

1GB DDR3 X16 533MHZ

CPU:龙芯2K0500



FPGA

网络PHY芯片

## 关键特点

支持标准IPMI2.0  
通信协议

双冗余IPMB接口,  
更可靠

模块集成隔离器件  
具备总线故障  
自动隔离功能

支持健康状态信息监控  
上下电时序控制  
WEB人机交互

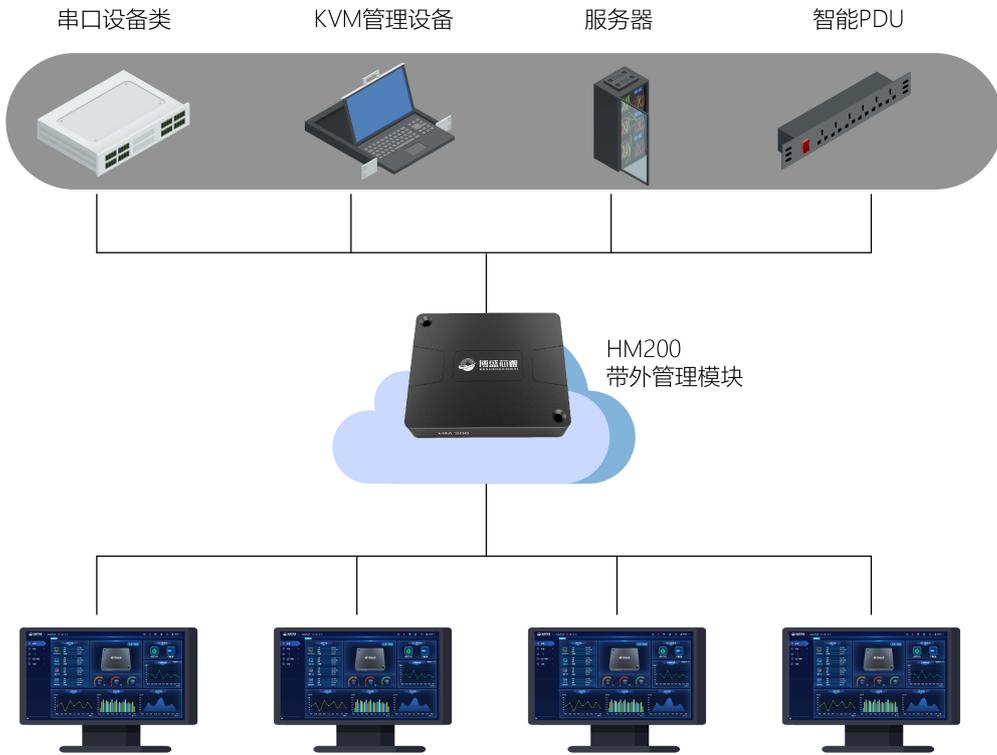
支持远程SOL  
远程iKVM  
远程固件更新功能

全国产化  
自主可控

# HM200 带外管理模块 | 应用场景

- ★ 串口设备类
- ★ 服务器

- ★ KVM管理设备
- ★ 智能PDU



## 规格参数

硬件平台	
处理器	龙芯2K0500
缓存	1GB DDR3 X16 533MHZ
存储	1GB SD NAND SD2.0协议
软件平台	
操作系统	嵌入式Linux
远程控制	iKVM、SOL、远程媒体介质
软件升级	本地升级
	远程升级
接口	
接口协议	IPMI2.0
PCIE	PCIE2.0×1
USB	USB2.0×2
网络	1路1000BASE-T
ADC接口	ADC×8
串口通讯	TTL 8线串口×2；2线串口×4
地址检测口	地址检测口×6
调试串口	2线串口×1

供电	
供电	5V
物理参数	
尺寸	63mm×13mm×53mm (带结构)
外壳	6063铝合金
环境参数	
工作温度	商业级 (0°C~70°C)
贮存温度	工业级 (-40°C~80°C)
国产化率	
国产化率	国产化元器件数量及种类比例均为95%
	国产化元器件数量及种类比例均为100%